PCT/JP 01/00406 本国特許庁 20.02. 01



本 国 特 許
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

REC'D 02 MAR 2001
WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 1月24日

JP01/406

出 顧 番 号 Application Number:

特願2000-013786

出 類 人 Applicant (s):

三井化学株式会社

illi trakt käre latti artootaska kit ti (tälkalaristaanks)

Children season

PRIORITY
DOCUMENT

庁

in it

2001年 2月 9日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 及川耕



出証番号 出証特2001-3006207

特許願

【整理番号】

38000003

【提出日】

平成12年 1月24日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01L 33/00

C08L 75/04

【発明者】

【住所又は居所】

福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井化学株式会社内

【氏名】

山田 国博

【発明者】

【住所又は居所】

福岡県大牟田市浅牟田町30番地 三井化学株式会社内

【氏名】

伊藤 尚登



THE SOURCE

is singues de

【氏名】

鳥巣 正昭

【特許出願人】

【識別番号】

000005887

医偏偏 [] [[基本]] [[基本]]

三井化学株式会社

甲四 宏幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

005278

【納付金額】

21,000円

1

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



明細書

【発明の名称】 発光素子の封止材

【特許請求の範囲】

【請求項1】イソシアナート化合物と、ポリオールとを加熱して反応する事 から得られる発光素子の封止材。

【請求項2】インシアナート化合物が、脂肪族および/または脂環式ポリイ ソシアナート化合物からなる請求項 1 記載の発光素子の封止材。

【請求項3】イソシアナート化合物が、2,5-および/または2,6-ジ イソシアナトメチルビシクロ「2.2.1] ヘプタン混合物からなる請求項1記 載の発光素子の封止材。

【発明の詳細な説明】

0001

ード(以下LEDと略す)などの発光素子の封止材に関 する。

[0002]

【従来技術】

されてきた。

いられており、エポキシ樹脂と硬化剤と硬化促進材と離型剤を含有するエポキシ 樹脂組成物を用いてトランスファー成形等により比較的簡単に形成されることが できる。例えば、特開平11-43586記載のエポキシ樹脂組成物は、比較的 着色の少ない、ビスフェノールA型、ビスフェノールF型、ビスフェノールS型 **等のエポキシ樹脂、あるいはオルトクレゾール、フェノール等のノボラック型エ** ポキシ樹脂、および脂環式系エポキシ樹脂等が例示され、硬化剤としては、無水 ヘキサヒドロフタル酸、無水メチルヘキサヒドロフタル酸、無水テトラヒドロフ タル酸等の酸無水物、あるいはフェノール、クレゾール、キシレノール、レゾル シン等とホルムアルデヒド等とを縮合反応させて得られるノボラック型樹脂、こ の他にアミン系の硬化剤等を用いた半導体素子封止用エポキシ樹脂組成物が開発 [0003]

一方、光ファイバー用コーティング剤として開発されたてきた、特開平5-3 2749号公報記載のウレタン(メタ)アクリレート、これを用いた樹脂組成物 および硬化物もLED用封止剤等に使用することができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、一般にLEDの発光素子の封止材料として用いられるエポキシ樹脂は 熱または光による着色があり、光透過率が低下しLEDの性能低下させること、 表面実装型LEDを封止する際に表面が硬化しない等の問題点があった。

[0005]

また、ウレタン (メタ) アクリレートを用いたい樹脂組成物では、フッ素含有 (メタ) アクリル酸エステルを一旦製造し、その後ポリオールと有機ポリイソシ

であり、且つ高価であるため、LED用封止材としては工業的に不利である。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明者らはこれらの課題を解決するために、鋭意検討した結果、熱硬化性ポップレタン樹脂を用いて比較的容易にしEDの発光素子を封止することができる 硬化性が良好であり、着色が少なく、且つ安価な樹脂であること見いだし、本発明に到達した。

[0007]

すなわち、本発明は、以下のものである。

- 1) イソシアナート化合物と、ポリオールとを加熱して反応する事から得られる 発光素子の封止材。
- 2) イソシアナート化合物が、脂肪族および/または脂環式ポリイソシアナート 化合物からなる請求項1記載の発光素子の封止材。
- 3) イソシアナート化合物が、2,5-および/または2,6-ジイソシアナト メチルビシクロ[2.2.1] ヘプタン混合物からなる請求項1記載の発光素子



[0008]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。本発明におけるイソシアナート化合物は、ヘキサメチレンジイソシアナート(HDI)、1ーイソシアナトー3,3,5ートリメチルー5ーイソシアナトメチルシクロヘキサン(IPDI)、キシリレンジイソシアナート(XDI)、2,5ーおよび/または2,6ージイソシアナトメチルピシクロ[2.2.1] ヘプタン(NBDI)、水添キシリレンジイソシアナート(水添XDI)、水添ジフェニルメタンジイソシアナート(水添MDI)、トリシクロドデカンジイソシアナート(TCDI)、およびその誘導体例えば、ヌレート、アロフェネート、アダクト、ウレトジオン等の脂肪族および/または脂環族のポリイソシアナート化合物である。好ましくは、ビシクロ環を有する

ヘプタンであり、例えば、特開平3-220167に記載の酢酸・ノアミルとオルトジクロルベンゼンの混合溶媒を用い、2,5-および/または2,6-ジアミノメチルビシクロ[2.2.1] ヘプタンと塩酸ガスで2,5-および/または2,6-ジアミノメチルビシクロ[2.2.1] ヘプタンの塩酸塩を得、16

不活性ガスを吹き込み系内のホスゲンを除去、その後溶媒を除き、減圧下精留す る方法等で製造される。

[0009]

本発明におけるポリオールは、グリセリン、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、1,3ーブタンジオール、1,4ーブタンジール、ネオペンチルグリコール、1,5ーペンタンジオール、1,6ーヘキサンジオール、2,2ージメチルー1,3ープロパンジオール、3ーメチルー1,5ーペンタンジオール、2ーエチルー1,3ーヘキサンジオールおよび1,3ーヒドロキシベンゼン、1,3ーピス(2ーヒドロキシエトキシ)ベンゼン、等のジオール類、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、1,3ーヘキサンジオール、1,4ーヘキサンジオ

ール、1,2,6-ヘキサントリオールおよびこれらのプロピレンオキサイド、エチレンオキサイド付加物等のトリオール類、ペンタエリスリトールおよびこれらプロピレン、エチレンオキサイド付加物、またはポリエステルポリオール、ポリエーテルポリオール、およびポリアクリルポリオール等のポリオール類、イノシトート、キシリトール、ソルビトール、果糖、グルコース等の糖類が挙げられる。これらのポリオールは単独で用いてもよいし、2種以上を併用してもよい。

[0010]

本発明に係る発光素子封止材は、ポリイソシアナートまたはその誘導体とポリオールとを加熱して反応させて得られた物であれば特に限定されないが、ポリイソシアナートとポリオールの量は、NCO基/OH基=0.8~1.2になるようにするのが好ましく、NCO基/OH基=0.9~1.1になるようにするのがより好ましい。反応はイソシアナート化合物中にポリオールを加えて混合するのが好ました。だった。また、ポリオールを2種以上併用

ましく、相溶することがより好ましい。触媒は使用しても、使用しなくてもよいが、使用する場合はウレタン化触媒であれば特に限定はないが、有機金属系触媒が好ましく、有機スズ系触媒がより好ましい。触媒を使用する場合の触媒使用量は、イソシアナート化合物に対して、0.001~5重量が存ましくは0.1~2重量%であるが、LED用としては風媒なしが好ました。成形温度は4.2~220℃が好ましく、60℃~180℃がより好ましい。成形時間は、1分~10時間が好ましく、1時間~7時間がより好ましい。更に60℃~180℃で1時間~12時間アフターキュアーすることが好ましい。

[0011]

【実施例】

以下、実施例により本発明を具体的に説明する。尚、GPC測定にはカラムShodexAD-8025Sを用い、移動相にN,N-ジメチオルホルムアミドを使用し測定した。

[0012]

実施例1

2,5-および/または2,6-ジイソシアナトメチルビシクロ[2.2.1] ヘプタンの混合物(以下NBDIと略す)206.2g(1モル)を25℃で 攪拌しながら、2-エチル-1,3-ヘキサンジオール146.2g(1モル)を仕込み10分間攪拌混合して均一に溶解させた後、この均一溶液を金型に移液し、不活性ガス雰囲気下100℃で5時間反応させ150℃で3時間アフターキュアーの処理を行い無色透明なポリウレタン樹脂を得た。図1、および図2に得られたポリウレタン樹脂のIRチャート、およびGPCチャートを示した。

[0013]

実施例2

2-xチル-1, 3-ヘキサンジオール1 3 1 . 6 g (0 . 9 モル)を2 5 $\mathbb C$ にて攪拌しながら、グリセリン 6 . 1 g (0 . 0 6 6 モル)を混合し、溶液(A 液と略す)1 3 7 . 7 g を得た。N B D I 2 0 6 . 2 g (1 モル)を2 5 $\mathbb C$ に攪

後、実施例1同様に100℃で5時間反応させ150℃で3時間アンターキュア ーの処理を行い無色透明なポリウレタン樹脂を得た。

[0014]

実施例3

1603

にて攪拌しながら、1,4-ヘキサンジオール11.6g(0.1モル)を混合し、溶液(B液と略す)143.2gを得た。NBDI206.2g(1モル)を25℃で攪拌しながら、B液143.2gを仕込み10分間攪拌混合して均一に溶解させた後、実施例1同様に100℃で5時間反応させ150℃で3時間アフターキュアーの処理を行い無色透明なポリウレタン樹脂を得た。

[0015]

実施例4

NBDI206.2g(1モル)を25℃で攪拌しながら、2-エチル-1,3-ヘキサンジオール146.2g(1モル)を仕込み10分間攪拌混合して均一に溶解させた溶液を用い、100℃で5時間反応させ、150℃で3時間アフターキュアーの処理を行い、ランプ型LEDの発光素子を成形させて青色発色の

LEDチップを制作した。

[0016]

比較例1

実施例4で作られたランプ型LEDチップ、および市販されているエポキシ樹脂ピスフェノール系で発光素子を封止した青色発色のランプ型LEDを用い、温度25℃、湿度50%の恒温室内で電流50mAで1000時間連続通電させたところ、実施例4で作られたランプ型LEDには着色なく、市販されているランプタイプLEDは発光素子部分が黄変した。

[0017]

【発明の効果】

本発明によれば、イソシアナート化合物と、脂肪族および/または脂環族ポリオールとを加熱して反応して得られる樹脂で、比較的簡単に発光素子を封止でき

【図面の簡単な説明】

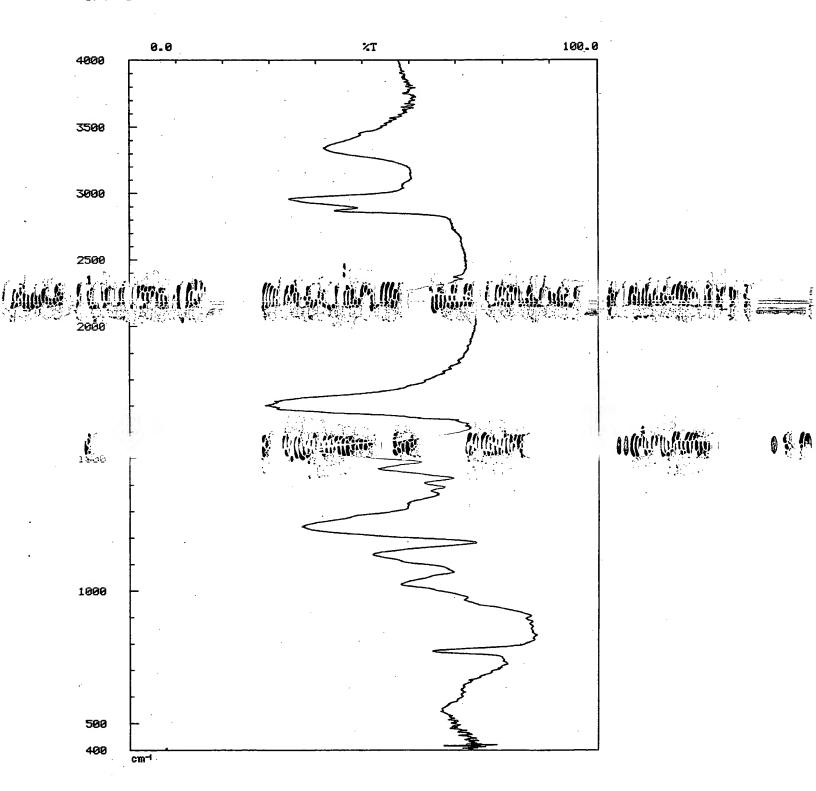
【図1】

実施例1の方法で得た無色透明なポリウレタン樹脂のIRチャートである。

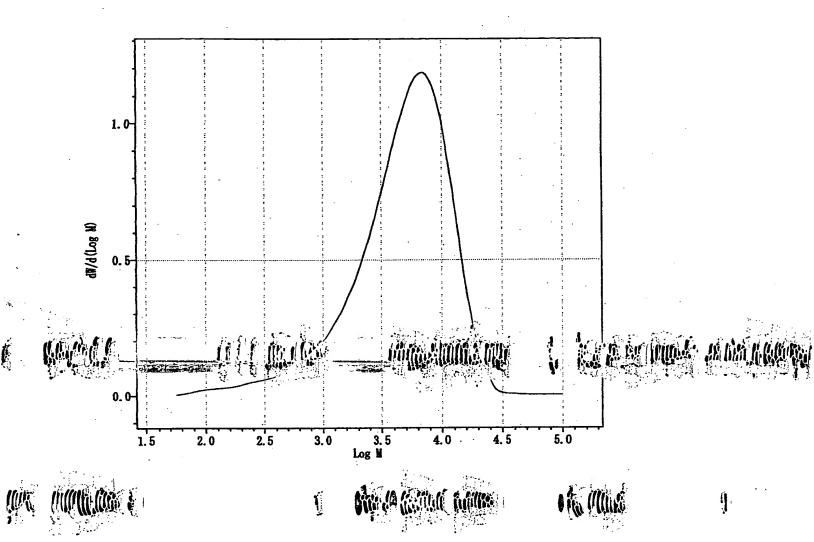
実施例1の方法で得た無い透明なポリウレタン樹脂のGPCチャート

図面

【図1】



【図2】



要約書

【要約】

【課題】硬化性が良好であり、着色が少なく、且つ安価な発光素子の封止材の提供。

【解決手段】2,5-および/または2,6-ジイソシアナトメチルビシクロ[2.2.1] ヘプタン混合物とポリオールとを加熱して反応する事から得られる発光素子の封止材。

【選択図】

なし



11 %

Mille

o Millian Ton

出願人履歴情報

識別番号

[000005887]

1. 変更年月日

1997年10月 1日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

氏 名

三井化学株式会社



